

Panne de dessoudage composite Chip I - Hakko T9-I

Réf. article HK-T9-I

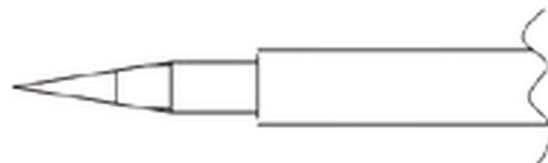
Fabricant Hakko

EAN 4962615011955

Panne de dessoudage composite Chip I de rechange pour la brucelle de dessoudage parallèle mini Hakko FM-2023. Lot de 2 pannes. Conçue pour les travaux de dessoudage de précision sur les assemblages de circuits imprimés compacts.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T9-I est une panne de dessoudage composite au format I, spécialement conçue pour être utilisée avec la brucelle de dessoudage parallèle mini FM-2023. Ce jeu de pannes de rechange contient deux pièces et a été conçu pour offrir des performances de dessoudage fiables sur les circuits imprimés compacts et à forte densité de composants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction composite pour une durabilité et une conductivité thermique accrues
- Conception de panne au format I optimisée pour les brucelles parallèles mini
- Compatible avec le système de dessoudage Hakko FM-2023
- Lot de 2 pannes de rechange
- Conception ESD pour la protection des composants sensibles
- Fabrication de précision pour des résultats de dessoudage constants

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	Chip I
Compatibilité	Brucelle parallèle mini Hakko FM-2023
Quantité par lot	2 pièces
Matériau	Composite
Sécurité ESD	Oui
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de dessoudage de précision sur les assemblages de circuits imprimés compacts, la reprise de composants et les opérations de réparation dans les espaces restreints. Convient aussi bien à la réparation électronique professionnelle qu'aux environnements de fabrication.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 × Panne de dessoudage composite Chip I (Format I)